

2020 年 10 月 23 日

三菱ガス化学株式会社

プリント配線板用積層材料事業に係る合弁契約締結について

三菱ガス化学株式会社(本社:東京都千代田区、社長:藤井 政志、以下、当社)は、台湾の電子材料メーカーである聯茂電子股份有限公司(董事長:陳進財、以下、聯茂)と共同開発した製品を製造販売することを目的とした合弁会社の設立に関する契約を締結しましたのでお知らせいたします。

当社機能化学品事業部門電子材料事業部では、当社独自の BT レジンを用いた高耐熱性、低熱膨張性を特徴とするプリント配線板用積層材料を半導体パッケージ用途に展開し、市場で高く評価され、これまでに携帯電話、パソコン、自動車などの半導体用途に幅広く採用されています。

半導体市場は、データセンター向け投資の拡大、次世代通信規格(5G)の本格的普及、自動車業界における技術革新(CASE/ADAS)などによって後押しされ、益々伸長していく事が期待されています。

当社と聯茂は本合弁会社の設立を通じて、両社が有する技術や設備、知見を活用し、今後も拡大していく半導体市場の要求に応えるため、半導体パッケージ用積層材料について新たな製品の提供に取り組んでまいります。

<主な合意内容>

- ・台湾における合弁会社の設立(各国・地域の競争法当局の承認取得が前提)
- ・合弁会社の出資比率は、当社 51%、聯茂 49%
- ・合弁会社の事業範囲は、半導体パッケージ用積層材料に関するプリント配線板用銅張積層板およびプリプレグの製造販売

<聯茂電子股份有限公司の概要>

会社名 : 聯茂電子股份有限公司(英語名 ITEQ CORPORATION)

所在地 : 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路 17 號

設 立 : 1997 年 4 月 10 日

資本金 : 3,330 百万ニュー台湾ドル(2020 年 9 月末現在)

売上高 : 23,791 百万ニュー台湾ドル(2019 年 12 月期)

董事長 : 陳進財

事業内容: プリント配線板用銅張積層板およびプリプレグの製造販売

従業員数: 3,347 名 (2020 年 9 月末現在)

以 上